

低温易烧结陶瓷用 α - Al_2O_3

概述: 采用优质氧化铝原料, 严格控制煅烧工艺, 用 99.8% 氧化铝球做研磨介质, 不带入其它杂质。可以在很低温度下实现陶瓷的致密烧结。不仅可以改善陶瓷性能, 而且能显著降低能源消耗。

用途:

广泛应用于泡沫陶瓷、微晶陶瓷、陶瓷刀具、防弹陶瓷、精密陶瓷等应用领域。

主要技术指标

型号	Al_2O_3 (%) $\geq$	SiO_2 (%)	Fe_2O_3 (%)	Na_2O (%)	MgO (%)	α - Al_2O_3 (%) $\geq$	平均 粒度 um	烧结 密度 g/cm^3
JH-YC1	99.8	0.02	0.015	0.04		95	0.3	3.9
JH-YC2	99.8	0.02	0.015	0.04	0.05	95	0.3	3.93

YC1、YC2 在 1540℃ 烧结成瓷

低温烧结陶瓷用 α - Al_2O_3

概述: 采用优质氧化铝原料, 严格控制煅烧工艺, 用 99.8% 氧化铝球做研磨介质, 不带入其它杂质。可以在较低温度下实现陶瓷的致密烧结。不仅可以改善陶瓷性能, 而且能显著降低能源消耗。

用途:

广泛应用于泡沫陶瓷、微晶陶瓷、陶瓷刀具、精密陶瓷; 也可应用于高性能耐火材料、研磨抛光材料等领域。

主要技术指标

型号	Al_2O_3 (%) $\geq$	SiO_2 (%) $\leq$	Fe_2O_3 (%) $\leq$	Na_2O (%) $\leq$	α - Al_2O_3 (%) $\geq$	平均粒度 um	烧结密度 g/cm^3
JH-DC1	99.8	0.03	0.03	0.04	95	0.5-0.8	3.93

DC1 在 1580℃ 烧结成瓷

低温烧结陶瓷用 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$

概述：采用优质氧化铝原料，严格控制煅烧工艺，用 99.8% 氧化铝球做研磨介质，不带入其它杂质。可以在较低温度下实现陶瓷的致密烧结。不仅可以改善陶瓷性能，而且能显著降低能源消耗。

用途：

广泛应用于泡沫陶瓷、微晶陶瓷、陶瓷刀具、精密陶瓷；也可应用于高性能耐火材料、研磨抛光材料等领域。

主要技术指标

型号	Al ₂ O ₃ (%) ≥	SiO ₂ (%) ≤	Fe ₂ O ₃ (%) ≤	Na ₂ O (%) ≤	MgO (%) ≤	a-Al ₂ O ₃ (%) ≥	平均 粒度 um	烧结 密度 g/cm ³ ≥
JH-DC2	99.8	0.03	0.03	0.06		95	1-1.5	3.9
JH-DC3	99.8	0.03	0.03	0.06	0.05	95	1-1.5	3.92

DC2、DC3 在 1650℃ 烧结成瓷